



上海天玑科技股份有限公司

关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年4月26日